

令和6年8月7日
FIoT コンソーシアム 新世代パッケージング分科会
会長 竹井裕介
主査 岡田浩尚、岡本有貴、森田伸友

令和6年度 第1回 新世代パッケージング分科会開催のご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムの分科会活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様、大変お待たせいたしました。今年2月に新設した当分科会ですが、ようやく第1回の分科会開催日程が決まりました。記念すべき第1回の分科会では、招待講演として熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構の卓越教授であります青柳昌宏先生に、熊本大学での取り組み及び当分科会への期待をご講演いただきます。また直近の関連国際学会として、IEEE MEMS、IEEE ECTC について、予稿集から研究動向を掘り下げます。皆様、奮ってご参加ください。

敬具

記

日時:2024年8月29日(木) 14:00~17:00

※対面@産総研つくば事業所東地区と、オンライン(Microsoft Teams)のハイブリッド開催。

プログラム (※講演は質疑応答の時間を含みます)

- 14:00~14:10 開会の挨拶、新世代パッケージング分科会の趣旨説明
- 14:10~15:00 講演「熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構の取り組みと FIoT 新世代パッケージングへの期待(仮)」 熊本大学 青柳昌宏 卓越教授
- 15:00~15:10 休憩
- 15:10~15:40 IEEE MEMS 2024 動向調査報告
- 15:40~16:10 IEEE ECTC 2024 動向調査報告
- 16:10~16:20 次回案内、事務連絡等
- 16:30~17:00 (現地参加の方)つくば事業所東地区 見学